

Silspher D23

专利号: ZL 201510781190.X

名称: 球形多孔二氧化硅

Silspher D23 球形多孔二氧化硅, 属于粒径大小不均一类型。采用优质硅源, 经过沉淀法造球工艺生产而来, 作为功能性粉体填充剂和添加剂, 可满足许多苛刻的应用。高硬度耐刮擦、化学性能稳定、耐冲击耐水煮、高耐候、折光率接近树脂做高透明度材料、高球化率、提升在零件上的填充率, 低密度颗粒减少零件重量, 降低成本并增强产品性能。在覆铜板、电子封装、LED、油墨、胶粘剂、油漆涂料、吸附缓释体、催化剂载体等方面有广泛的应用。中值粒径 3 微米的小颗粒产品, 在有特殊细度要求的纺织、油墨、胶粘剂、膜材料上性能更加优越。

产品参数:

外观: (目测)	白色粉末
颗粒粒径, D50: μm (激光粒度分布仪)	3
吸油量ml/100g	100
pH值: (2%水分散液, 直测)	5.0-9.0
干燥失重: (%, 105°C, 3小时)	≤ 2

产品特征及主要应用:

产品特征:

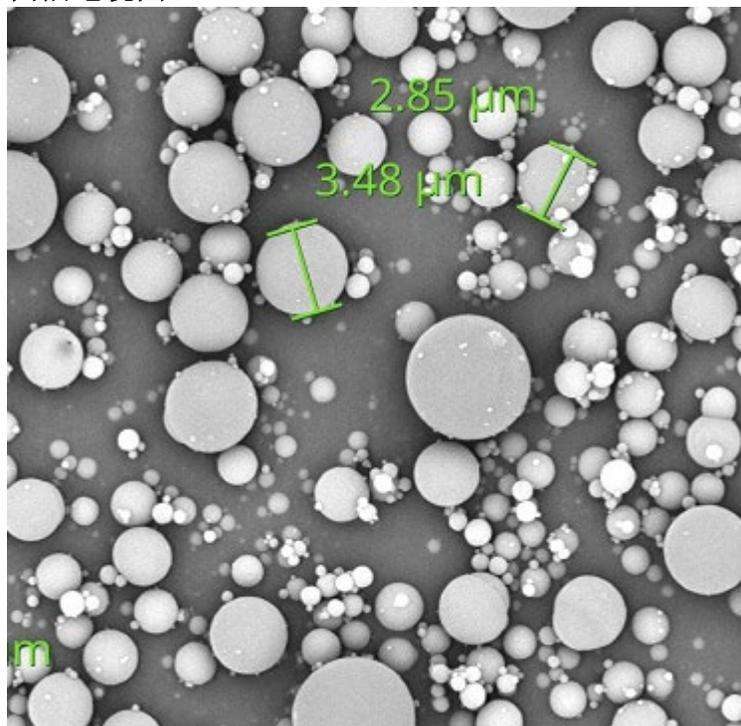
- 1、球形白色粉体, 球化率高, 无气味
- 2、流动性强、滑爽性优, 应力低, 方便添加分散
- 3、99.9%含量高纯度二氧化硅, 金属杂质, 磁性离子含量少 100ppm
- 4、多孔结构、高孔隙率高孔容积、比表面积小、吸附性能优异, 缓释效果明显
- 5、化学性能稳定、无定型结构、非晶态无放射性元素、无毒无味, 耐高温、耐化学腐蚀、耐酸碱耐候性能稳定
- 6、 $3\mu\text{m}$ 中值粒径, 粒度分布窄, 填充密实度更好
- 7、低介电常数 3.88/k、低损耗 0.0002 (1MHZ), 低膨胀 0.5×10^{-6} , 优越的绝缘填充料
- 8、折光率 1.5 左右, 与大多树脂折光率接近, 在橡塑、涂料、胶粘剂、LED 灯罩等产品中使用, 透光率高
- 9、莫氏硬度 6, 耐冲击、耐刮、耐磨, 增加体系强度
- 10、公司具有多种表面改性产品可选, 分散性能优越
- 11、球形结构, 球面多孔、易散射, 吸收光线, 消光哑光效果明显

主要应用:

- 1、电子行业: 覆铜板、电子封装、LED
- 2、胶黏剂、

- 3、涂料、
- 4、油墨、
- 5、纺织、
- 6、膜材料

扫描电镜图：



(D23 电镜图)

仓储信息：

产地：	中国
包装规格：	25 kg/桶
存储方法：	密封，阴凉干燥处避光保存
保质期：	36 个月

编制日期：2022/02/23